



PH相变化导热垫片-PH Thermal PAD

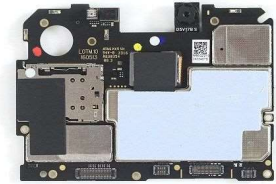
技术数据表 Technical Data Sheet



产品描述

PH相变化导热垫片是一种高性能低熔点导热相变化材料。在温度52℃时，导热相变化材料开始软化并流动，填充散热片和发热器件的接触界面上细微不规则间隙，以达到减小热阻的目的。导热相变化材料在室温下呈可弯曲固态，无需增强材料而独立使用，免除了增强材料对热传导性能的影响。

PH系列导热相变化材料在温度130℃下持续1000小时，或经历-25℃到125℃的反复循环测试，其导热性能仍不会减退。在工作温度下，其中相变材料软化的同时又不会完全液化或溢出。



Typical Applications :

- 高速缓存芯片
- 移动及通讯设备
- 高频率微处理器
- 微处理器/图形处理器
- 大型存储设备

Features/Benefits :

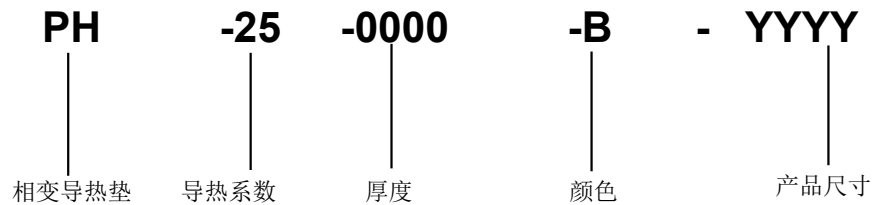
- 超低热阻
- 受热流动，但不是硅油
- 室温下具有天然黏性
- 证明长期的可靠性
- 散热器无需预热

典型性能		相变化导热垫片				单位	测试方法
		PH10	PH15	PH25	PH48		
物理性能	颜色	白色	灰色	粉红色	浅兰		目测
	厚度	0.076-0.254	0.076-0.254	0.13-0.254	0.13-0.454	mm	ASTM-D374
	密度	2.1	2.2	2.5	2.8	g/cm ³	ASTM-D792
	硬度	-	-	-	-	-	ASTM-D2240
	延伸率	-	-	-	-	-	ASTM-D412
	抗撕裂强度	-	-	-	-	-	ASTM-D412
	重量损失	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	%	EN-344
热性能	导热系数	1.0	1.5	2.5	4.8	W/m.k	ASTM D5470
	有效工作温度	-30~130	-30~130	-30~130	-30~130	℃	EN-344
常规性能	RoHS	YES	YES	YES	YES		SGS
	保质期	18	18	18	18	months	Zesion
	热阻	0.016	0.018	0.036	0.042	in2/W@50Pis	ASTM D5470

(continued on next page)

相变化导热垫片标准规格为200*400或200*300（长*宽，单位mm），厚度为0.076-0.454

可以使用下面的料号进行物料信息识别



示例

PH100076G2525= 导热系数1.0W厚度0.076mm灰色25*25相变导热垫片

PH250127Y3030= 导热系数2.5W厚度0.127mm黄色30*30相变导热垫片

PH480454P30405= 导热系数4.8W厚度0.454mm粉红色30*40相变导热垫片

This information and our technical advise – whether verbal, in writing or by way of trials – are given in good faith but without warranty, and this also applies where proprietary rights of third parties are involved. Our advice does not release you from the obligation to check its validity and to test our products as to their suitability for the intended processes and uses. The application, use and processing of our products and the products manufactured by you on the basis of our technical advice are beyond our control and, therefore, entirely your own responsibility. Our products are sold in accordance with our General Conditions of Sale and Delivery.